



新闻动态

- ▶ 图片新闻
- ▶ 头条新闻
- ▶ 综合新闻
- ▶ 学术活动
- ▶ 科研动态
- ▶ 通知公告
- ▶ 业内信息
- ▶ 合作交流

现在位置: 首页 > 新闻动态 > 科研动态

微电子所牵头973“超高频、大功率化合物半导体器件与集成技术基础研究”项目申请成功

2009-09-02 | 编辑: | 【大】 【中】 【小】 【打印】 【关闭】

近日,由微电子所微波器件与集成电路研究室(四室)刘新宇研究员为首席科学家的973计划“超高频、大功率化合物半导体器件与集成技术基础研究”项目经科技部评审答辩顺利申请成功。

该项目由中科院微电子所作为主要承担单位,其它参加单位还包括半导体所、物理所、上海微系统所、清华大学、南京大学、西安电子科技大学、中电13所以及北京理工大学八家单位。该项目是在前期973项目的基础上以进一步提高化合物半导体器件的频率和功率,引领学科发展为牵引,将器件的研究成果应用到电路及系统中,满足国家需求为目标。通过本项目的研究,可以将化合物半导体器件和电路从吉赫兹推进到太赫兹、毫米波大功率领域,实现器件研究到集成技术应用的突破。

“超高频、大功率化合物半导体器件与集成技术基础研究”项目的顺利实施将有力推动我国宽禁带化合物半导体器件和电路的基础研究和技术应用,提升中科院微电子所在该领域的研究优势。

附件下载:

相关新闻:

微电子所研制实现4GHz 4-bit的超高速ADC芯片

微电子所研制成功两款10GHz 8-bit的超高速DDS芯片

院地合作 携手创新 国内首款CMOS全球卫星导航接收芯片研发成功